

深圳长城开发科技股份有限公司（深科技） (000021)

个股分析报告

行业：存储半导体封测、电子制造服务、计量智能终端

报告日期：2026 年 9 月 14 日

行情数据截至 2026 年 9 月 11 日收盘；完整日线技术指标主要截至 2026 年 9 月 10 日，部分平台于 2026 年 9 月 11 日盘中/日度更新。

本报告基于公开信息由 AI 自动整理生成，仅供参考，不构成投资建议

一、核心摘要

深科技 2026 年上半年实现营业收入 82.78 亿元，同比增长 6.96%；归母净利润 5.43 亿元，同比增长 20.28%，扣非归母净利润 5.04 亿元，同比增长 58.80%，主营经营改善较为明显。但利润中仍包含投资收益 3917.9 万元及公允价值变动收益 9511.2 万元，归母净利润增速不宜完全线性外推。公司拟投入 18.5 亿元扩充高端存储芯片封测及 2.5D/3DS 先进封装产能，项目计划于 2028 年 12 月建成，扩产将成为后续成长的重要变量。

公司 2025 年营业收入 157.47 亿元，其中高端制造、存储半导体和计量智能终端收入分别为 85.35 亿元、40.91 亿元和 30.21 亿元，毛利率分别为 9.71%、20.40%和 39.26%。存储半导体收入同比增长 16.16%，是业务结构升级和利润率改善的重要支撑；高端制造规模最大但盈利能力相对较低，计量智能终端毛利率较高但 2026 年上半年收入同比下降 19.18%。

公司处于存储芯片后道封测、EMS 及计量智能终端产业链中游，具备深圳、合肥双基地以及 Bumping、RDL、超薄存储芯片 PoPt、16 层堆叠和 uMCP SiP 等量产能力。2026 年上半年高端制造收入同比增长 20.78%，而存储半导体收入仅增长 1.83%，显示当前增长仍由多业务共同贡献，存储封测景气恢复和先进封装产能兑现仍需观察。

截至 2026 年 9 月 11 日，公司股价 35.03 元，较 7 月 1 日 52 周高点 66.20 元回撤约 47.1%；当日成交额 29.08 亿元、换手率 5.29%，并出现放量下跌及主力资金净流出。股价重新低于 MA5、MA10 和 MA20，短线技术面偏弱；同时 TTM 市盈率约 45 倍，当前估值已包含一定增长预期。

二、公司概况

2.1 基本信息

项目	内容
股票代码	000021
证券简称	深科技
控股股东体系	中国电子信息产业集团有限公司
报告期	截至 2025 年 12 月 31 日
主营业务	存储半导体、高端制造、计量智能终端
业务模式	提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流及销售等一站式服务，具有国际化 EMS 属性
生产及服务网络	布局中国、香港、亚太及其他海外地区
2025 年营业收入	157.47 亿元

2.2 主营业务与产品布局

存储半导体：主要从事 DRAM、NAND Flash 及嵌入式存储芯片的高端封装与测试，产品包括 DDR4/DDR5、LPDDR4/LPDDR5、UFS、uMCP 等，采用深圳、合肥双基地布局。2025 年收入 40.91 亿元，占营业收入 25.98%，同比增长 16.16%，毛利率 20.40%。

- 高端制造：属于电子制造服务 EMS 范畴，提供电子产品研发支持、工艺设计、零部件采购、生产制造、组装测试、物流及供应链管理等服务。2025 年收入 85.35 亿元，占营业收入 54.20%，同比增长 2.93%，毛利率 9.71%。
- 计量智能终端：主要服务能源计量和智慧能源管理场景，产品包括智能电表、能源计量终端及相关智能终端产品。公司已为全球 43 个国家和地区、80 余家能源公司提供超过 9800 万只智能计量产品。2025 年收入 30.21 亿元，占营业收入 19.18%，同比增长 2.91%，毛利率 39.26%。

2.3 产业链上下游地位与成本利润结构

深科技横跨存储半导体封测、高端制造 EMS 和计量智能终端三类业务，整体处于电子产业链中游制造环节。其中，存储封测位于存储器产业链后道，连接晶圆及芯片供应与终端应用；高端制造提供制造及供应链服务；计量智能终端面向电网、海外电力公司及其他能源公用事业客户。

- 存储半导体封测业务的上游投入包括客户提供或指定的存储晶圆、芯片及相关设计规格，以及封装基板、引线框架、粘接膜、模塑料、键合线、镀钎铜线等封装材料；同时需要测试机、探针台、研磨设备、封装设备、治具、电力、洁净厂房、设备折旧和工程研发投入。
- 公司正在推动粘接膜、基板、镀钎铜线等核心材料的国产化验证和客户端导入，显示封装材料及设备是供应链自主可控的重要成本和风险环节。
- 高端制造 EMS 业务上游主要为客户指定或公司采购的电子元器件、PCB、结构件、存储器件、连接器及其他生产物料。2024 年年报显示，材料费约 92.85 亿元，占营业成本 75.88%，材料成本驱动特征明显。
- 计量智能终端上游主要涉及电子元器件、通信模块、计量芯片、PCB、结构件及终端组装材料；公司公开年报未披露各类物料的具体采购金额占比。
- 截至 2025 年 12 月 31 日，公司前五名供应商采购金额 19.25 亿元，占年度采购总额 18.22%，第一大供应商占 5.45%。该数据来自公司 2025 年年度报告；年报未披露具体供应商名称及核心材料、关键设备或特定芯片物料的细分依赖程度。
- 公司对存储芯片价格通常不具备决定性影响，盈利更多取决于封测加工费、产品结构、良率、产能利用率、材料成本及客户订单稳定性；高端制造和计量终端也受到上游电子物料价格及供应保障影响。
- 下游客户主要包括存储器和硬盘产业链客户、电子产品及通信消费电子和工业电子等 EMS 客户，以及国家电网、海外电力公司和其他能源公用事业客户。
- 截至 2025 年 12 月 31 日，公司前五大客户合计销售金额 90.16 亿元，占年度销售总额 57.25%，第一大客户占 20.44%；2024 年这一比例分别为 52.40% 和 24.11%。数据来自公司年度报告，但年报未披露客户具体名称，市场文章对客户名称的对应关系缺少公司公告交叉确认。
- EMS 客户通常在产品定价、年度降价、质量赔偿、交付节奏和库存管理方面具有较强议价权；存储封测客户掌握晶圆、产品规格及订单分配权，封测厂商议价能力取决于技术认证、良率、产能稀缺性和交付稳定性。
- 计量智能终端客户以电网等大型能源客户及海外电力公司为主，项目通常受到招投标、认证、客户采购价格和付款条件约束，收入确认和订单节奏还可能受到电网投资及海外项目进度影响。
- 截至 2025 年 12 月 31 日，应收账款 42.50 亿元，占总资产 15.92%；以 2025 年营业收入 157.47 亿元粗略计算，年末应收账款/全年收入约 27.0%。2024 年末应收账款 39.36 亿元，占总资产 14.70%，对应应收账款/全年收入约 26.5%。上述静态指标显示公司存在较明显营运资金占用，但不能替代应收账款周转天数。公开年报摘要和可检索文本未能完整交叉核实 2025 年各业务线的应收账款周转天数、预付款及应付账款分业务数据。
- 截至 2025 年 12 月 31 日，前五大客户销售占比 57.25%，高于前五大供应商采购占比 18.22%，说明公司整体客户集中度高于供应商集中度，在大客户订单、定价及信用账期方面并非完全占据主导地位。客户和供应商比例来自公司年度报告，可信度较高，但客户及供应商具体名称和分业务依赖程度未披露。

年度	毛利率	净利率	简要说明
2021 年	9.64%	5.06%	EMS 及硬盘相关业务占比较高，整体制造属性较强，材料成本和客户议价压制毛利。
2022 年	12.02%	4.27%	毛利率较 2021 年改善，但存储及电子制造需求、产品结构和费用因素使净利率承压。
2023 年	16.65%	5.78%	存储半导体封测占比提升、产品结构改善，封测业务毛利率修复；公司对高端存储封测的投入开始体现。
2024 年	16.98%	7.33%	存储半导体收入增长、计量智能终端业务改善以及财务费用变化共同推动利润率上升。净利率口径部分来自第三方数据库整理，应以年度报告审计数据复核。
2025 年	18.32%	9.19%	存储半导体和计量智能终端保持较高毛利，高端制造毛利率较 2024 年改善；同时财务费用为负 4.18 亿元，金融衍生品交割收益增加，净利率提升不应全部归因于主营业务改善。

深科技处于“存储芯片后道封装测试+电子制造服务+智能计量终端”的中游制造位置：高端制造规模最大但毛利率较低，存储封测和计量终端具有相对更高的技术或认证壁垒。未来利润改善主要取决于高端存储封测产能释放、先进封装及高堆叠产品占比提升、客户结构优化、产能利用率提高、封装材料国产化降本，以及高端制造向 ODM/JDM 和高附加值制造升级，而非单纯依赖收入规模扩张。

三、财务数据与估值分析

3.1 近期经营业绩

报告期	营业收入	同比	归母净利润	同比
2023 年度	142.6465 亿元	未披露	6.4460 亿元	未披露
2024 年度	148.2717 亿元	未披露	9.3035 亿元	未披露
2025 年度	157.4739 亿元	6.21%	11.3568 亿元	22.07%
2025 年上半年	77.3965 亿元	未披露	4.5182 亿元	未披露
2026 年上半年	82.7846 亿元	6.96%	5.4345 亿元	20.28%

截至 2026 年 9 月 14 日，最新正式披露财报为 2026 年半年度报告，报告期截至 2026 年 6 月 30 日，披露日期为 2026 年 8 月 26 日；暂未检索到 2026 年三季度正式财报。2026 年上半年扣非归母净利润为 5.0429 亿元，同比增长 58.80%，扣非后基本每股收益为 0.3203 元。

2026 年上半年收入增长主要来自高端制造业务，收入 47.2249 亿元，同比增长 20.78%；存储半导体收入 21.3802 亿元，同比增长 1.83%；计量智能终端收入 13.5713 亿元，同比下降 19.18%。公司营业利润为 7.7059 亿元，同比增长约 4.98%。报告期内投资收益为 3917.9 万元，公允价值变动收益为 9511.2 万元，占利润总额的比例分别约为 5.07%和 12.30%，其中公允价值变动收益主要来自金融衍生品，存在一定波动性。扣非净利润增速显著高于归母净利润增速，显示主营经营有所改善，但后续估值不宜完全按照 2026 年上半年归母净利润线性外推。2023 年至 2025 年，公司收入由 142.6465 亿

元增至 157.4739 亿元，保持中个位数增长；归母净利润由 6.4460 亿元增至 11.3568 亿元，利润增速高于收入增速。2025 年扣非归母净利润为 9.6793 亿元，同比增长 7.48%，低于归母净利润增速，非经常性损益对利润增长有一定贡献。

3.2 盈利预测

机构预测覆盖有限。截至 2026 年 9 月 11 日，部分行情终端统计为 2 家机构对 2026—2028 年业绩进行预测；详细研报页面主要展示国投证券，另一家预测数据由汇总数据及国泰海通研报交叉确认，不能视为广泛市场一致预期。终端汇总预测显示 2026—2028 年归母净利润复合增速约为 28%—29%，核心假设包括存储半导体封测业务回暖、产能扩张及利润率改善。国投证券与国泰海通对 2026 年归母净利润预测分别为 16.64 亿元和 14.04 亿元，对 2027 年预测分别为 24.24 亿元和 16.73 亿元，预测差异较大。

年度	营业收入	归母净利润	净利润增速	每股收益(EPS)
2026 年（终端汇总预测）	约 192.7 亿元	15.34 亿元	未披露	约 0.98 元
2027 年（终端汇总预测）	约 229.3 亿元	20.49 亿元	未披露	约 1.30 元
2028 年（终端汇总预测）	约 267.1 亿元	25.44 亿元	未披露	约 1.62 元
2026 年（国投证券）	204.30 亿元	16.64 亿元	未披露	1.06 元
2027 年（国投证券）	250.37 亿元	24.24 亿元	未披露	1.54 元
2028 年（国投证券）	284.28 亿元	30.31 亿元	未披露	1.93 元
2026 年（国泰海通）	181.10 亿元	14.04 亿元	未披露	0.89 元
2027 年（国泰海通）	208.26 亿元	16.73 亿元	未披露	1.06 元
2028 年（国泰海通）	249.91 亿元	20.56 亿元	未披露	1.31 元

3.3 估值水平与机构评级

机构	评级	日期	备注
国投证券	买入-A	2026 年 6 月 12 日	目标价 46.20 元；估值依据为 2027 年 30 倍 PE。
国泰海通	增持	2026 年 6 月 21 日	目标价 51.76 元；采用 PE 和 PS 相结合的估值方式，以 2026 年 4.5 倍 PS 测算合理市值约 814.93 亿元。

截至 2026 年 9 月 11 日收盘，公司股价 35.03 元，总市值约 555.16 亿元，TTM 市盈率约 45.23 倍，扣非市盈率约 48.08 倍，市净率约 3.36 倍。部分其他行情终端显示市净率约 4.14—4.17 倍，主要可能源于净资产口径、股本口径或数据更新时间差异，PB 数据需统一口径复核。按 2026 年 9 月 11 日收盘价计算，终端汇总、国投证券、国泰海通 2026 年前瞻 PE 分别约为 35.7 倍、33.0 倍和 39.4 倍；2027 年前瞻 PE 分别约为 26.9 倍、22.7 倍和 33.0 倍；2028 年前瞻 PE 分别约为 21.6 倍、18.2 倍和 26.7 倍。公司静态或 TTM PE 约 45 倍、扣非 PE 约 48 倍，绝对估值不低；估值能否合理化取决于机构预测的兑现程度。当前估值已包含一定未来利润增长预期，若 2026—2027 年利润兑现不及预期，估值消化可能主要依赖时间而非业绩快速增长。主要不确定性包括存储半导体封测景气度、扩产后的产能利用率和折旧压力、高端制造业务稳定性、计量智能终端收入修复情况，以及金融衍生品公允价值变动和投资收益的可持续性。

四、近期消息与公告

4.1 拟投资 18.5 亿元扩大高端存储芯片封测及先进封装产能

2026 年 9 月 10 日，公司披露《关于子公司拟扩大高端存储芯片封测产能的公告》。全资子公司沛顿科技（深圳）有限公司拟实施高端存储芯片封测产能扩充项目，计划总投资 18.5 亿元。其中，约 12.2 亿元用于新设全资子公司深圳沛顿半导体封测有限公司并建设新厂房，新厂房预计可承载传统封测产能 9 万片/月及 2.5D 先进封装产能 1 万片/月；约 6.3 亿元用于建设 2.5D/3DS 先进封装研发线，建成达产后预计新增 2.5D 先进封装产能 100 片/月、3DS 先进封装产能 100 片/月。项目计划于 2028 年 12 月建成，新厂房项目预计税前投资回收期为 12.01 年。新厂房项目资金中约 6.4 亿元为自筹资金，约 5.8 亿元拟通过借款或银行贷款解决，研发线项目资金来源为自筹资金。公司称项目旨在把握 AI 产业增长带来的先进封装机会，满足战略客户需求，突破技术和产能瓶颈。项目不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东会审议。公司提示，存储市场下行、设备稼动率下降等因素可能增加折旧压力、延长投资回收期，项目经济效益存在不确定性。公告未披露具体客户名称、已签订单金额、预期收入及利润贡献。来源：深圳证券交易所公告 PDF：<https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/1cc5cf67-8e7c-469a-aa86-51c48bf760cc.PDF>

4.2 董事长韩宗远退休离任，周庚申接任董事长并任法定代表人

2026 年 9 月 10 日，公司披露《关于公司董事长退休离任暨选举董事长的公告》。原董事长韩宗远因达到法定退休年龄，辞去第十届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会及提名委员会职务，并辞去法定代表人职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至公告披露日，韩宗远不持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会于 2026 年 9 月 9 日选举董事周庚申为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会一致。周庚申因工作调整辞去公司副总裁职务，并被补选为董事会战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员。公司法定代表人将变更为周庚申，并办理工商变更登记。周庚申现年 59 岁，具有清华大学相关教育背景，拥有教授级高级工程师职称，持有公司股份 20,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东不存在关联关系。公告显示此次变更系退休及工作调整，未披露因监管、经营或重大风险导致的管理层变动。来源：深圳证券交易所公告 PDF：<https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/6443f885-04c7-49b9-ad5a-b3f0d4594f65.PDF>

4.3 董事会审议通过董事长选举、专门委员会补选及扩产议案

2026 年 9 月 10 日，公司披露第十届董事会第二十四次会议决议公告。董事会会议于 2026 年 9 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议审议通过选举周庚申为第十届董事会董事长、补选董事会专门委员会委员、子公司拟扩大高端存储芯片封测产能等三项议案，三项议案均获 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。来源：深圳证券交易所公告 PDF：<https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/f7cd48d8-cc52-4644-9b0b-40ad9a72798a.PDF>

4.4 2026 年 9 月暂无新增业绩预告，半年度净利润同比增长 20.28%

截至 2026 年 9 月 14 日，未发现公司新披露的 2026 年前三季度业绩预告、业绩预增或业绩预减公告。公司最近一项正式业绩披露为 2026 年半年度报告，披露日期为 2026 年 8 月 26 日。2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 5.43 亿元，同比增长 20.28%；扣除非经常性损益后的净利润约为 5.04 亿元，同比增长 58.80%；基本每股收益为 0.3452 元。半年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。上述数据为定期报告数据，不是业绩预告或市场预测。来源：深圳证券交易所 2026 年半年度报告 PDF：<https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ff2464a5-4a0f-48e4-9c6e-184b4ed6623e.PDF>

4.5 公司称生产经营正常，存储封测业务稼动率随订单动态调整

2026 年 9 月 2 日投资者互动信息显示，公司回应称目前生产经营和各项业务开展一切正常，存储封测业务稼动率随客户订单需求动态调整，公司将根据市场节奏灵活调配产能资源。互动内容未披露具体稼动率、订单金额或 HBM 业务量化进展，属于管理层定性表述，不能替代正式经营数据。来源：<https://stock.stockstar.com/RB2026090200043023.shtml>

4.6 截至 9 月 14 日未披露新增回购或增持计划

截至 2026 年 9 月 14 日，未检索到公司在 2026 年 9 月新增股份回购、控股股东增持或董监高增持计划公告。9 月 2 日公司就回购问题回应称重视股东价值回报，未来将努力做好生产经营，如有相关计划，将根据相关规定履行信息披露义务；9 月 8 日公司再次表示重视自身价值提升和股东价值回报，如有相关计划将履行信息披露义务。上述表述未披露具体回购金额、价格区间、实施期限或董事会审议安排，不构成回购承诺，也不代表公司已制定或批准回购方案。来源：<https://stock.stockstar.com/RB2026090200043023.shtml>；<https://yuanchuang.10jqka.com.cn/20260908/c679699838.shtml>

4.7 8 月 31 日股东户数降至 472,405 户，暂未发现新增增减持计划

截至 2026 年 8 月 31 日，公司 A 股股东户数为 472,405 户，较 2026 年 8 月 20 日的 489,589 户减少 17,184 户，下降 3.51%；2026 年 7 月 31 日股东户数为 503,894 户，8 月 31 日较 7 月 31 日累计减少 31,489 户，约下降 6.25%。股东户数连续下降不能直接等同于大股东增持、机构建仓或公司基本面改善，仍需结合正式权益变动公告和定期报告中的前十大股东数据判断。截至 2026 年 9 月 14 日，未检索到控股股东中国电子有限公司、持股 5%以上股东博旭（香港）有限公司新增减持或增持计划公告。2026 年半年度报告披露，股票期权激励计划自主行权导致 2026 年上半年新增股本 641,360 股，公司总股本由 1,573,728,420 股增加至 1,574,369,780 股，该事项不属于控股股东主动增持。来源：<https://basic.10jqka.com.cn/000021/holder.html>；https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12538300&stockid=000021

4.8 暂未发现新增监管处罚、重大诉讼或并购重组事项

截至 2026 年 9 月 14 日，未检索到公司在 2026 年 9 月新增监管问询函、纪律处分、行政处罚、重大诉讼或重大并购重组公告。公司披露的高端存储芯片封测产能扩充项目明确不构成关联交易，也不构成重大资产重组，因此不应将该项目归类为并购或重大资产重组。公告提及项目与 AI 产业增长、先进封装技术和高端存储芯片需求有关，但未披露具体政府补贴、产业基金投资、税收优惠或政策性资金支持金额，不能据此推断公司已获得相关政策资金。需要注意的是，本纪要截至 2026 年 9 月 14 日，公开公告检索到的最新正式公告主要截至 2026 年 9 月 10 日，9 月 11 日至 9 月 14 日如有未被及时收录的公告，应以巨潮资讯网和深圳证券交易所公告为准。

五、股价走势与技术面分析

5.1 价格概况

指标	数值
证券简称及交易所	深科技；深圳证券交易所主板
最新收盘价	35.03 元（2026 年 9 月 11 日）
当日涨跌	-1.47 元，-4.03%
当日开盘/最高/最低	35.21 元 / 35.28 元 / 34.08 元
当日成交量	约 83.87 万手
当日成交额	约 29.08 亿元
当日换手率	5.29%
52 周最高/最低	66.20 元（2026 年 7 月 1 日） / 19.75 元；部分复权页面显示低点为 19.64 元
总市值/流通市值	约 555.16 亿元 / 约 555.08 亿元
市盈率口径	动态市盈率约 50.74 倍，静态市盈率约 48.30 倍，TTM 市盈率约 44.91 倍；不同平台约 45.23 倍至 46.82 倍，存在口径差异

5.2 技术指标

指标	数值	简要解读
MA5、MA10、MA20	35.26 元、35.86 元、37.18 元（截至 2026 年 9 月 10 日完整日线数据）	9 月 11 日收盘价 35.03 元重新低于三条均线，短线技术状态较 9 月 10 日转弱；MA20 位于上方，构成中期压力。另一平台截至 9 月 11 日盘中/日度更新约为 34.65 元、35.51 元、35.31 元，因计算时间、复权方式及参数不同，仅作方向性校验。
MACD	DIF -1.43，DEA -1.51，MACD 柱+0.16（截至 2026 年 9 月 10 日）	DIF 略高于 DEA、柱体转正，显示短线反弹动能有所修复；但 DIF 和 DEA 仍在零轴下方，暂不能确认中期反转。9 月 11 日完整 MACD 数据缺失，不能将 9 月 10 日数值视为收盘后的精确值。
RSI	RSI6 56.0、RSI12 46.6、RSI24 46.1（截至 2026 年 9 月 10 日）	RSI6 位于 30 至 70 之间，未显示典型超买或超卖状态。另一平台截至 9 月 11 日盘中/日度更新的 RSI14 约为 46.25，日度综合评级偏弱。
布林带	上轨 41.38 元，中轨 37.18 元，下轨 32.98 元（截至 2026 年 9 月 10 日）	9 月 10 日股价位于中轨下方、下轨上方，处于布林带下半区；约 32.98 至 41.38 元的通道较宽，反映前期大幅波动后仍有较高价格弹性。9 月 11 日完整布林带数据缺失。

指标	数值	简要解读
52 周价格位置	最新收盘价 35.03 元，较 52 周高点 66.20 元低约 47.1%，较 52 周低点 19.75 元高约 77.4%	股价在 2026 年 7 月初冲高后明显回撤，当前处于 52 周区间中部偏上，但短期已由快速上涨转为高波动回撤和弱势震荡。
主力资金流向	2026 年 9 月 11 日：超大单净流入-1.0586 亿元，大单净流入-1.0621 亿元，中单净流入-0.5247 亿元，小单净流入+2.6454 亿元	按超大单加大单口径，主力资金净流出约 2.12 亿元，占当日成交额约 7.3%；当日下跌、主力净流出与小单净流入同时出现，资金结构偏弱。近 10 个交易日主力资金合计净流出约 8.56 亿元，3 天净流入、7 天净流出。

深科技股价在 2026 年 7 月 1 日触及 52 周高点 66.20 元后明显回撤，2026 年 9 月 11 日收于 35.03 元。当日成交额约 29.08 亿元、换手率 5.29%，成交额高于近 5 日约 23.29 亿元的平均水平，但股价下跌 4.03%，且主力资金净流出约 2.12 亿元，表现为放量下跌。技术上，收盘价重新低于 MA5、MA10 和 MA20；截至 9 月 10 日的 MACD 柱虽为正，但双线仍处于零轴下方，反弹更接近弱势修复，尚未形成中期反转确认。布林带下轨约 32.98 元、中轨约 37.18 元，短期价格处于下半区。

5.3 短线走势展望（未来一周，情景推演，仅供参考）

⚠ 风险提示：以下内容仅为基于已披露价格、成交和技术指标的主观情景推演，不构成投资建议，也不构成买卖、持有或止损指令。

① 关键技术位置

位置	区间	说明
短期压力	35.40~36.00 元	对应 9 月 11 日收盘价上方的 MA5、MA10 附近，也接近公开技术页面给出的短线枢轴及阻力区域。若不能有效收复，反弹更可能属于弱势修复；若放量突破 36.00 元，可观察 36.50~36.90 元一带。
第一支撑	34.50~35.00 元	接近近期多次交易形成的短线低位区域，并覆盖部分技术枢轴支撑。若有效跌破 34.50 元，下方支撑可能向 33.00~34.00 元移动。
强支撑	33.00~34.00 元	接近布林带下轨 32.98 元及近期交易低点 34.01 元附近。若放量跌破该区间，技术上将打开向 32 元附近甚至更低区间试探的可能；若缩量止跌并伴随资金回流，则可观察超短线反弹基础。

② 未来一周情景（主观权重，非统计概率）

- 震荡整理（相对权重较高，约五成至六成；为基于当前技术形态、成交量和资金流向的主观启发式权重，不是统计概率）：价格区间约 34.50~36.20 元。触发条件为守住 34.50 元附近支撑，主力资金净流出幅度收窄，且单日成交额回落至约 15 亿~25 亿元的近期常态区间。该情景下可观察股价围绕 35 元上下波动，36 元附近仍可能存在压力。

- 偏弱下行（权重中等；为主观启发式权重，不是统计概率）：价格区间约 33.00~34.50 元。触发条件为放量跌破 34.50 元、主力资金连续净流出，且成交额明显高于近期均值但下跌收盘。该情景下可观察布林带下轨约 33 元附近的支撑；若成交额放大而小单承接不足，波动率可能进一步上升。
- 反弹走强（权重偏低；为主观启发式权重，不是统计概率）：价格区间约 36.20~38.00 元。触发条件包括重新站上 36.00~36.50 元，并出现至少约 30 亿元以上成交额，同时主力资金由净流出转为持续净流入。若放量突破 36 元并连续维持，可视为修复力度增强的观察条件；37.18 元布林中轨及 MA20 附近仍是重要压力。

③ 资金与流动性背景

截至 2026 年 9 月 11 日，换手率为 5.29%，成交额约 29.08 亿元；近 10 个完整交易日成交额约 15.62 亿~41.75 亿元，近 5 日成交额约 15.62 亿~41.75 亿元，近 5 日平均约 23.29 亿元，近 10 日平均约 22.12 亿元。当前日均成交规模较大，流动性总体不属于极低水平，但 9 月 11 日出现成交额高于近期均值、股价明显下跌、主力净流出的组合，说明下跌过程中存在较强筹码交换。截至 2026 年 8 月 31 日，股东总数为 472405 户；截至 2026 年 6 月 30 日，前十大流通股东合计持有约 61899.17 万股，占流通股本约 39.32%，同花顺数据显示机构合计持股约 6.24 亿股，占流通 A 股 39.65%。集中度主要由控股股东中国电子持股约 34.21% 贡献；截至 2026 年 6 月 30 日，公募基金、保险、QFII 及境外机构均有出现，但机构持仓较 2025 年 12 月 31 日减少约 5947.91 万股。前十大股东及机构持仓数据截至 2026 年 6 月 30 日，距 9 月 11 日约两个半月；8 月 31 日股东户数虽已更新，但未同步披露完整前十大股东变化，因此当前筹码结构可能已发生变化，不能替代最新资金流向数据。

可检查的量价确认信号是：若未来一周股价重新站上 36.00~36.50 元，单日成交额持续达到约 30 亿元以上，同时主力资金不再连续净流出，可视为短线资金承接改善的观察信号；若放量但仍收于 34.50 元下方，则更应理解为卖压释放，而非有效突破。

④ 关注要点（仅为观察思路，非操作指令）

- 观察思路，非操作指令：关注 34.50~35.00 元支撑是否有效，若跌破则观察 33.00~34.00 元强支撑区。
- 观察思路，非操作指令：关注 35.40~36.00 元能否重新收复，36.50 元附近可作为进一步观察反弹强度的参考位置。
- 观察思路，非操作指令：关注成交额是否连续达到约 30 亿元以上，并与主力资金净流入同步出现。
- 观察思路，非操作指令：关注 MACD 能否继续维持 DIF 高于 DEA，并逐步向零轴上方修复。

以上情景推演基于 2026 年 9 月 11 日收盘数据及截至 2026 年 9 月 10 日可获得的历史价格、技术指标测算，短期股价还会受消息面、资金面、大盘环境等多重因素扰动，技术指标本身存在滞后性和局限性，不构成对未来实际走势的保证，也不构成买卖建议，请结合最新市场信息独立判断并自行承担投资风险。

六、行业格局与竞争对手分析

6.1 行业现状

半导体封测位于集成电路产业链后道，连接晶圆制造与终端应用，具有资本密集、技术密集和规模效应特征。深科技重点布局存储半导体封装测试，同时以 EMS 高端制造和计量智能终端形成业务组合。

6.2 竞争格局

- 半导体封测核心竞争要素包括先进封装技术、封装良率和测试能力、客户认证周期及长期合作关系、设备材料及工程研发能力、稳定产能规模和产能利用率，以及对高性能计算、存储、汽车电子等市场的覆盖能力。
- 全球封测市场集中度较高，日月光、安靠、长电科技、通富微电、华天科技、力成科技、京元电子等处于主要竞争阵营。行业市场份额受统计口径、是否纳入 IDM 内部封测及数据来源影响，不同资料之间不一定严格可比。
- 中国大陆封测行业已形成内资企业主导、头部集中度提升的格局，长电科技、通富微电和华天科技综合规模较大，深科技则更加突出 DRAM、NAND Flash 及相关嵌入式存储封装测试。
- 存储封测的竞争重点包括高堆叠、超薄芯片和高密度封装工艺，DRAM、NAND Flash、UFS、LPDDR 等产品量产经验，大规模测试能力和测试程序开发能力，以及与存储晶圆厂、模组厂和终端客户的长期认证关系。
- 深科技采用深圳、合肥双基地布局，具备 Bumping 及 RDL 量产、超薄存储芯片 PoPt 封装量产、16 层堆叠和 uMCP SiP 封装量产能力，并推进 32 层 NAND Flash 高堆叠封装、UFS4.1 及 GDDR 多芯片倒装封装等技术。
- 截至 2025 年末，公司未披露覆盖全公司的统一当前总封装或总测试月产能口径。2026 年 5 月披露的约 14.70 亿元扩产项目属于计划新增产能，预计 2027 年分阶段投产，不能计入截至 2025 年末的现有产能。

6.3 主要竞争对手

公司	定位	说明
长电科技（600584）	中国大陆综合规模较大的半导体封测企业，覆盖晶圆级封装、系统级封装、倒装、引线键合、2.5D/3D 等技术。	相较深科技，长电科技在综合封测规模、先进封装技术和全球客户覆盖方面更强；深科技在存储封测专业化、双基地布局及国内存储产业链协同方面更具针对性。
通富微电（002156）	主要封测企业，强项包括高性能计算、CPU/GPU、通信和先进封装。	通富微电在逻辑芯片、高性能计算和先进封装领域综合竞争力更强；深科技在 DRAM、NAND Flash 存储封测及硬盘存储产业链方面更具针对性。
华天科技（002185）	主要封测企业，覆盖传统封装、BGA、FC、晶圆级封装和系统级封装，应用于消费电子、通信、汽车和工业电子等领域。	华天科技业务广度和封测规模较大；深科技则形成存储封装测试、电子制造和计量终端三条业务线组合，双方在存储及通用封测领域部分竞争。
甬矽电子（688362）	主要聚焦集成电路封装测试，布局中高端封装、晶圆级封装及相关测试，覆盖模拟、射频、图像传感和消费电子等领域。	甬矽电子更偏向中高端逻辑、模拟及晶圆级封装；深科技更偏向存储半导体封测和大型 EMS 综合制造，产品结构存在差异。
日月光/安靠	全球大型综合封测企业，在规模、客户覆盖、先进封装平台和全球制造网络方面处于国	适合作为深科技的全球行业标杆，不属于经营规模、业务范围和全球化程度完全相同的严格 A 股估值可比公司。

公司	定位	说明
	际领先地位。	

深科技与长电科技、通富微电、华天科技等综合型封测企业存在部分竞争，但业务结构并不完全相同。其相对优势在于存储封测专业化、深圳和合肥双基地、国内存储产业链协同，以及存储封测、EMS 和计量智能终端的组合能力；相对短板是整体业务仍包含较大规模的传统或高端制造业务，在全球综合封测规模、先进封装广度和全球品牌影响力方面与综合型龙头存在差距。

七、风险提示

- 存储封测扩产存在投资回收和产能利用率风险：公司拟投入 18.5 亿元建设传统封测及 2.5D/3DS 先进封装产能，项目预计 2028 年 12 月建成，但尚未披露具体客户、已签订单、预期收入和利润贡献；若存储市场下行或设备稼动率不足，可能增加折旧压力并延长投资回收期。
- 存储半导体业务增长和盈利受订单、产品结构及封测稼动率影响：2026 年上半年该业务收入仅同比增长 1.83%，公司同时表示稼动率随客户订单动态调整，未披露具体稼动率和订单金额，先进封装产能释放存在不确定性。
- 客户集中度较高且议价能力偏弱：2025 年前五大客户销售占比 57.25%，第一大客户占 20.44%；EMS 客户在定价、年度降价、质量赔偿、交付和库存管理方面具有较强议价权，重点客户订单或付款条件变化可能影响收入和利润。
- 高端制造业务规模大但毛利率较低：2025 年该业务收入占比 54.20%，毛利率仅 9.71%，且材料费在 2024 年约占营业成本 75.88%；若电子元器件、PCB、结构件等物料成本上升，或客户降价压力加大，利润率可能承压。
- 计量智能终端业务收入出现下滑：2026 年上半年收入 13.57 亿元，同比下降 19.18%；该业务受电网投资、海外项目进度、招投标、认证、采购价格和付款条件影响，收入修复节奏具有不确定性。
- 公司存在较明显的营运资金占用和客户信用风险：2025 年末应收账款 42.50 亿元，占总资产 15.92%，约相当于全年营业收入的 27.0%；同时前五大客户销售占比高于前五大供应商采购占比，公司在大客户账期和信用条件方面并非完全占据主导地位。
- 利润中非主营及金融因素存在波动风险：2025 年财务费用为负 4.18 亿元，金融衍生品交割收益增加；2026 年上半年公允价值变动收益 9511.2 万元、投资收益 3917.9 万元，若相关收益减少或转为损失，归母净利润可能低于主营业务表现所反映的水平。
- 当前估值和股价波动带来业绩兑现风险：截至 2026 年 9 月 11 日股价 35.03 元，TTM 市盈率约 45 倍，静态及动态市盈率约 48 至 51 倍；若 2026—2027 年利润低于机构预测，估值消化可能依赖较长时间。技术面上股价低于 MA5、MA10 和 MA20，且当日主力资金净流出约 2.12 亿元，短期波动风险较高。

八、结论与展望

深科技的中长期增长逻辑主要来自存储半导体封测业务扩张、先进封装技术和产能升级，以及高端制造向 ODM/JDM 和高附加值制造演进。18.5 亿元扩产项目若能匹配战略客户需求并实现较高稼动率，有望提升存储封测收入和利润贡献；但项目新厂房税前投资回收期预计为 12.01 年，且具体客户、已签订单、收入及利润贡献尚未披露，成长兑现具有较长周期。

2026 年上半年扣非利润增速明显高于归母净利润增速，反映主营改善，但高端制造收入增长与计量智能终端下滑并存，业务表现仍有分化。机构对 2026 年归母净利润预测为 14.04 亿至 16.64 亿元、

2027 年为 16.73 亿至 24.24 亿元，预测差异较大；在当前约 45 倍 TTM 市盈率下，估值合理性取决于存储封测景气、扩产利用率、利润率改善及预测兑现程度。

后续应重点跟踪存储封测订单和稼动率、先进封装项目建设进度及资本开支回报、高端制造客户和利润率变化、计量智能终端收入修复，以及金融衍生品收益对利润的影响。公司董事长因退休离任并由周庚申接任，公告显示属于退休及工作调整，后续仍需关注管理层变更后的战略执行连续性。

数据来源

深科技(000021)_公司公告_深科技：2025 年年度报告摘要新浪财经_新浪网 —
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12247158&stockid=000021&utm_source=openai

深科技(000021)_公司公告_深科技：2025 年年度报告新浪财经_新浪网 —
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12247178&stockid=000021&utm_source=openai

深科技(000021)_公司公告_深科技：2025 年年度报告新浪财经_新浪网 —
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12247178&stockid=000021&utm_source=openai

https://reportify.cn/filings/1112883580138295296?utm_source=openai —
https://reportify.cn/filings/1112883580138295296?utm_source=openai

董事会决议 — https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202605261822885326_1.pdf?utm_source=openai

深科技(000021) - 基本面研究报告 - 爱股网 — https://www.iguuu.com/stock/000021/report?utm_source=openai

中国集成电路封测行业现状深度分析与投资前景预测报告（2026-2033 年）_观研报告网 —
https://www.chinabaogao.com/baogao/202602/779578.html?utm_source=openai

2025 年中国集成电路封测行业市场前景预测研究报告|集成电路_新浪财经_新浪网 —
https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2025-04-28/doc-ineusnva5447746.shtml?utm_source=openai

《行业深度》洞察 2022：中国集成电路封装行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)_行业研究报告 - 前瞻网 — https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/220225-7f95f5e0.html?utm_source=openai

深科技(000021)_股票行情，行情首页_中财网 — https://quotewh.cfi.cn/quote_000021.html

深科技(000021)_公司公告_深科技：2026 年半年度报告新浪财经_新浪网 —
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12538300&stockid=000021

深科技(000021)_公司公告_深科技：2026 年半年度报告新浪财经_新浪网 —
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12538300&stockid=000021&utm_source=openai

深科技(000021) 盈利预测_F10_同花顺金融服务网 — https://basic.10jqka.com.cn/48/000021/worth.html?utm_source=openai

深科技(000021.SZ)盈利预测-PC_HSF10 资料 — https://emweb.eastmoney.com/PC_HSF10/ProfitForecast/index?code=SZ000021&color=b&type=soft&utm_source=openai

深科技(000021) 盈利预测_F10_同花顺金融服务网 — <https://basic.10jqka.com.cn/48/000021/worth.html>

深科技(000021)首次覆盖报告：多业务协同发力 先进制造平台价值凸显_新浪财经_新浪网 —
https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/835391636662/index.phtml

机构评级/国投证券给予深科技“买入”评级 — <https://stock.10jqka.com.cn/20260612/c677427160.shtml>

深科技(000021)_股票行情，行情首页_中财网 — https://quotewh.cfi.cn/quote_000021.html?utm_source=openai

深科技(000021)股票信息 - 数据平台 — https://data.agoer.com/cms/Index/detail?id=000021&utm_source=openai

深科技(000021)公告(全部) - 理杏仁 —

<https://www.lixinger.com/equity/company/detail/sz/000021/21/announcement>

深科技 sz000021 的股票股价,行情,直播,新闻,财报,数据 - 爱股票 — https://stock.aigupiao.com/code/sz000021?utm_source=openai

深科技 (000021) 股价和资讯 - Google 财经 — https://www.google.com/finance/beta/quote/000021%3ASHE?hl=zh-CN&utm_source=openai

深科技(000021.SZ) 股票行情_历史数据_主力资金 - 大波浪数据 — https://www.yyqyx.com/s/000021.SZ?utm_source=openai

深科技(000021)股票行情走势技术分析_未来预测_买卖操作建议_英为财经 Investing.com — https://cn.investing.com/equities/shenzhen-kaifa-a-technical?utm_source=openai

深科技(000021)_资金流向_证券之星 — https://stock.quote.stockstar.com/capital_000021.shtml?utm_source=openai

深科技(000021)_股东户数_中财网 — https://quote.cfi.cn/gdhs/19/000021.html?utm_source=openai

深科技(000021) - 流通股股东 - 股票行情中心 - 搜狐证券 — https://q.stock.sohu.com/cn/000021/ltgd.shtml?utm_source=openai

本报告由 AI 基于公开渠道信息自动检索、整理并生成，信息截至 行情数据截至 2026 年 9 月 11 日收盘；完整日线技术指标主要截至 2026 年 9 月 10 日，部分平台于 2026 年 9 月 11 日盘中/日度更新。，可能存在时效性差异，具体数据请以公司正式公告及权威数据终端为准。本报告仅为信息整理与研究参考，不构成任何投资建议，投资者应独立判断并自行承担投资风险。